



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213583752 U

(45) 授权公告日 2021.06.29

(21) 申请号 202022653625.1

(22) 申请日 2020.11.16

(73) 专利权人 深圳市易天互联网络科技有限公司

地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街
道龙井村龙井高新科技金谷创业园C
栋507单元

(72) 发明人 易成伟

(74) 专利代理机构 北京棘龙知识产权代理有限公司 11740

代理人 戴丽伟

(51) Int. Cl.

H01L 23/367 (2006.01)

H01L 23/40 (2006.01)

H01L 23/31 (2006.01)

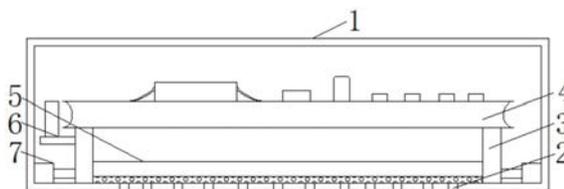
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种具有双层引脚的全息芯片

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有双层引脚的全息芯片,包括壳体,所述壳体的底端开设有多个散热孔,且壳体的内部底端固定连接有多支撑柱,所述支撑柱的顶端安装本体,且支撑柱的一侧安装有散热机构,所述散热机构的内部包括有多个滑槽,且滑槽与支撑柱的一侧之间为嵌合连接,所述滑槽的内部套接插设有滑块,且滑块的顶端固定连接有对接块,所述滑块的一侧固定连接散热板。本实用新型通过滑块在滑槽的内部移动,可将滑块一侧连接的散热板移动到本体的下方,便于通过散热板对本体进行散热,防止其温度过高,导致本体的损坏,影响其后续的使用,通过对接块与对接槽的连接,便于将散热板进行限位固定,便于对本体进行散热。



1. 一种具有双层引脚的全息芯片,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的底端开设有多个散热孔(2),且壳体(1)的内部底端固定连接有多个支撑柱(3),所述支撑柱(3)的顶端安装本体(4),且支撑柱(3)的一侧安装有散热机构(5),所述散热机构(5)的内部包括有多个滑槽(501),且滑槽(501)与支撑柱(3)的一侧之间为嵌合连接,所述滑槽(501)的内部套接插设有滑块(502),且滑块(502)的顶端固定连接有对接块(503),所述滑块(502)的一侧固定连接有散热板(504),且散热板(504)的底端连接有吸湿棉(505),所述吸湿棉(505)与壳体(1)的内部底端之间相连接,所述滑槽(501)的顶端嵌合连接有对接槽(506),且对接槽(506)与对接块(503)的表面之间为卡合连接,所述支撑柱(3)的一侧安装有理线机构(6),且支撑柱(3)的一侧安装有安装机构(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种具有双层引脚的全息芯片,其特征在于,所述散热板(504)通过滑块(502)与滑槽(501)之间构成滑动结构,且滑块(502)通过对接块(503)与对接槽(506)之间构成卡合结构。

3. 根据权利要求1所述的一种具有双层引脚的全息芯片,其特征在于,所述理线机构(6)的内部包括有C型板(601),且C型板(601)与支撑柱(3)的一侧之间为固定连接,所述C型板(601)的一侧嵌合连接有卡槽(602),且卡槽(602)的内部卡合连接有卡块(603),所述卡块(603)的一侧固定连接有移动板(604),且移动板(604)的底端固定连接有多个支撑杆(605),并且支撑杆(605)的底端固定连接有固定板(606),所述C型板(601)的一侧固定连接有限位板(607),且限位板(607)的顶端开设有多个通孔(608),所述移动板(604)的底端固定连接有复位弹簧(609),且复位弹簧(609)穿过限位板(607)与C型板(601)的顶端之间为固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种具有双层引脚的全息芯片,其特征在于,所述移动板(604)通过卡块(603)与卡槽(602)之间构成卡合结构,且移动板(604)通过复位弹簧(609)与C型板(601)之间构成弹性伸缩结构。

5. 根据权利要求1所述的一种具有双层引脚的全息芯片,其特征在于,所述安装机构(7)的内部包括有多个连接杆(701),且连接杆(701)与支撑柱(3)的一侧之间为固定连接,所述壳体(1)的内壁两侧之间分别固定连接有两个连接块(702),且连接块(702)的内部底端固定连接有第一限位槽(703),所述连接杆(701)的底端一侧安装有第一限位块(704),且第一限位块(704)与第一限位槽(703)的内部之间为卡合连接,所述连接杆(701)的顶端安装有挡板(705),且挡板(705)的一侧固定连接有第二限位块(706),所述连接块(702)的内壁一侧安装有第二限位槽(707),且第二限位槽(707)与第二限位块(706)的表面之间为卡合连接。

6. 根据权利要求5所述的一种具有双层引脚的全息芯片,其特征在于,所述挡板(705)通过第二限位块(706)与第二限位槽(707)之间构成卡合结构,所述连接杆(701)通过第一限位块(704)与第一限位槽(703)之间构成卡合结构。

一种具有双层引脚的全息芯片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及芯片技术领域,尤其涉及一种具有双层引脚的全息芯片。

背景技术

[0002] 芯片为集成电路,又称微电路、微芯片、晶片,芯片在电子学中是一种将电路,主要包括半导体设备,也包括被动组件等小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。

[0003] 现有的具有双层引脚的全息芯片其在使用的过程中,并不具备将芯片与外接的连接线进行限位固定,容易导致连接线从芯片上脱落,影响到设备的运行,以及其在长时间的工作下,容易导致其温度过高,在没有对其进行散热的情况下,容易导致芯片的损坏,影响后续的使用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于了解决现有的具有双层引脚的全息芯片其在使用的过程中,并不具备将芯片与外接的连接线进行限位固定,容易导致连接线从芯片上脱落,影响到设备的运行,以及其在长时间的工作下,容易导致其温度过高,在没有对其进行散热的情况下,容易导致芯片的损坏,影响后续的使用的缺点,而提出的一种具有双层引脚的全息芯片。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种具有双层引脚的全息芯片,包括壳体,所述壳体的底端开设有多个散热孔,且壳体的内部底端固定连接有多个支撑柱,所述支撑柱的顶端安装本体,且支撑柱的一侧安装有散热机构,所述散热机构的内部包括有多个滑槽,且滑槽与支撑柱的一侧之间为嵌合连接,所述滑槽的内部套接插设有滑块,且滑块的顶端固定连接有对接块,所述滑块的一侧固定连接有散热板,且散热板的底端连接有吸湿棉,所述吸湿棉与壳体的内部底端之间相连接,所述滑槽的顶端嵌合连接有对接槽,且对接槽与对接块的表面之间为卡合连接,所述支撑柱的一侧安装有理线机构,且支撑柱的一侧安装有安装机构。

[0007] 优选的,所述散热板通过滑块与滑槽之间构成滑动结构,且滑块通过对接块与对接槽之间构成卡合结构。

[0008] 优选的,所述理线机构的内部包括有C型板,且C型板与支撑柱的一侧之间为固定连接,所述C型板的一侧嵌合连接有卡槽,且卡槽的内部卡合连接有卡块,所述卡块的一侧固定连接移动板,且移动板的底端固定连接有多个支撑杆,并且支撑杆的底端固定连接固定板,所述C型板的一侧固定连接有限位板,且限位板的顶端开设有多个通孔,所述移动板的底端固定连接有复位弹簧,且复位弹簧穿过限位板与C型板的顶端之间为固定连接。

[0009] 优选的,所述移动板通过卡块与卡槽之间构成卡合结构,且移动板通过复位弹簧与C型板之间构成弹性伸缩结构。

[0010] 优选的,所述安装机构的内部包括有多个连接杆,且连接杆与支撑柱的一侧之间为固定连接,所述壳体的内壁两侧之间分别固定连接有两个连接块,且连接块的内部底端

固定连接有第一限位槽,所述连接杆的底端一侧安装有第一限位块,且第一限位块与第一限位槽的内部之间为卡合连接,所述连接杆的顶端安装有挡板,且挡板的一侧固定连接有第二限位块,所述连接块的内壁一侧安装有第二限位槽,且第二限位槽与第二限位块的表面之间为卡合连接。

[0011] 优选的,所述挡板通过第二限位块与第二限位槽之间构成卡合结构,所述连接杆通过第一限位块与第一限位槽之间构成卡合结构。

[0012] 本实用新型中,所述一种具有双层引脚的全息芯片的有益效果如下:

[0013] 1、本实用新型中,在散热机构的作用下,通过滑块在滑槽的内部移动,可将滑块一侧连接的散热板移动到本体的下方,便于通过散热板对本体进行散热,防止其温度过高,导致本体的损坏,影响其后续的使用,通过对接块与对接槽的连接,便于将散热板进行限位固定,便于对本体进行散热。

[0014] 2、本实用新型中,在理线机构的作用下,通过复位弹簧的作用,可使移动板通过卡块在卡槽的内部移动,可使移动板底端连接的固定板移动到限位板上,便于通过固定板以及限位板可将外接与本体连接的连接线进行限位固定,防止连接线从本体上脱落,影响设备的使用情况。

[0015] 3、本实用新型中,在安装机构的作用下,通过第一限位块与第一限位槽的连接,便于将连接杆以及支撑柱所连接的本体固定在壳体的内部,防止用螺栓将本体与壳体连接,螺栓长时间的情况下,容易导致其滑牙,影响后续对本体的维护或维修,通过第二限位块与第二限位槽的连接,便于将连接杆进行固定,防止连接杆连接的第一限位块从第一限位槽的内部脱落,影响本体的使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种具有双层引脚的全息芯片的结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型散热机构部分的结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型理线机构侧视的结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型安装机构的结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型安装机构部分俯视的结构示意图。

[0021] 图中:1壳体、2散热孔、3支撑柱、4本体、5散热机构、501滑槽、502滑块、503对接块、504散热板、505吸湿棉、506对接槽、6理线机构、601C型板、602卡槽、603卡块、604移动板、605支撑杆、606固定板、607限位板、608通孔、609复位弹簧、7安装机构、701连接杆、702连接块、703第一限位槽、704第一限位块、705挡板、706第二限位块、707第二限位槽。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0023] 参照图1-5,一种具有双层引脚的全息芯片,包括壳体1,壳体1的底端开设有多个散热孔2,且壳体1的内部底端固定连接有多个支撑柱3,支撑柱3的顶端安装本体4,且支撑柱3的一侧安装有散热机构5,散热机构5的内部包括有多个滑槽501,且滑槽501与支撑柱3

的一侧之间为嵌合连接,滑槽501的内部套接插设有滑块502,且滑块502的顶端固定连接有对接块503,滑块502的一侧固定连接有散热板504,且散热板504的底端连接有吸湿棉505,吸湿棉505与壳体1的内部底端之间相连接,滑槽501的顶端嵌合连接有对接槽506,且对接槽506与对接块503的表面之间为卡合连接,支撑柱3的一侧安装有理线机构6,且支撑柱3的一侧安装有安装机构7。

[0024] 本实用新型中,散热孔2是便于将壳体1内部的热量向外排出,吸湿棉505是防止外部的湿气进入到壳体1的内部,对其内部本体4的使用造成影响。

[0025] 参照图1-5,散热板504通过滑块502与滑槽501之间构成滑动结构,且滑块502通过对接块503与对接槽506之间构成卡合结构。

[0026] 本实用新型中,通过滑块502在滑槽501的内部移动,可将滑块502一侧连接的散热板504移动到本体4的下方,便于通过散热板504对本体4进行散热。

[0027] 参照图3,理线机构6的内部包括有C型板601,且C型板601与支撑柱3的一侧之间为固定连接,C型板601的一侧嵌合连接有卡槽602,且卡槽602的内部卡合连接有卡块603,卡块603的一侧固定连接有移动板604,且移动板604的底端固定连接有多个支撑杆605,并且支撑杆605的底端固定连接有固定板606,C型板601的一侧固定连接有有限位板607,且限位板607的顶端开设有多个通孔608,移动板604的底端固定连接有复位弹簧609,且复位弹簧609穿过限位板607与C型板601的顶端之间为固定连接。

[0028] 本实用新型中,复位弹簧609是便于移动板604通过卡块603在卡槽602的内部移动。

[0029] 参照图3,移动板604通过卡块603与卡槽602之间构成卡合结构,且移动板604通过复位弹簧609与C型板601之间构成弹性伸缩结构。

[0030] 本实用新型中,通过固定板606与限位板607的连接,便于将连接线限位固定在其之间,防止连接线的脱落。

[0031] 参照图4、图5,安装机构7的内部包括有多个连接杆701,且连接杆701与支撑柱3的一侧之间为固定连接,壳体1的内壁两侧之间分别固定连接有两个连接块702,且连接块702的内部底端固定连接有第一限位槽703,连接杆701的底端一侧安装有第一限位块704,且第一限位块704与第一限位槽703的内部之间为卡合连接,连接杆701的顶端安装有挡板705,且挡板705的一侧固定连接有第二限位块706,连接块702的内壁一侧安装有第二限位槽707,且第二限位槽707与第二限位块706的表面之间为卡合连接。

[0032] 本实用新型中,通过第一限位块704与第一限位槽703的连接,便于将连接杆701以及支撑柱3所连接的本体4固定在壳体1的内部。

[0033] 参照图4、图5,挡板705通过第二限位块706与第二限位槽707之间构成卡合结构,连接杆701通过第一限位块704与第一限位槽703之间构成卡合结构。

[0034] 本实用新型中,通过第二限位块706与第二限位槽707的连接,便于将连接杆701进行固定,防止连接杆701连接的第一限位块704从第一限位槽703的内部脱落,影响本体4的使用。

[0035] 本实用新型的工作原理如下:

[0036] 在本实用新型中,首先通过第一限位块704与第一限位槽703的连接,便于将连接杆701以及支撑柱3所连接的本体4固定在壳体1的内部,防止用螺栓将本体4与壳体1连接,

螺栓长时间的情况下,容易导致其滑牙,影响后续对本体4的维护或维修,通过第二限位块706与第二限位槽707的连接,便于将连接杆701进行固定,防止连接杆701连接的第一限位块704从第一限位槽703的内部脱落,影响本体4的使用,通过滑块502在滑槽501的内部移动,可将滑块502一侧连接的散热板504移动到本体4的下方,便于通过散热板504对本体4进行散热,防止其温度过高,导致本体4的损坏,影响其后续的使用,通过对接块503与对接槽506的连接,便于将散热板504进行限位固定,便于对本体4进行散热,通过复位弹簧609的作用,可使移动板604通过卡块603在卡槽602的内部移动,可使移动板604底端连接的固定板606移动到限位板607上,便于通过固定板606以及限位板607可将外接与本体4连接的连接线进行限位固定,防止连接线从本体4上脱落,影响设备的使用情况,就这样完成了本实用新型的工作原理。

[0037] 本实用的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限制,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接连接,也可以是通过中间媒介相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用中的具体含义。

[0038] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

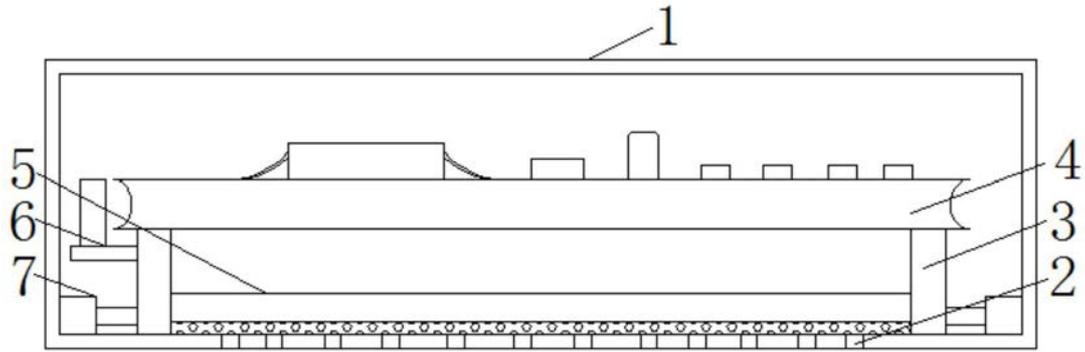


图1

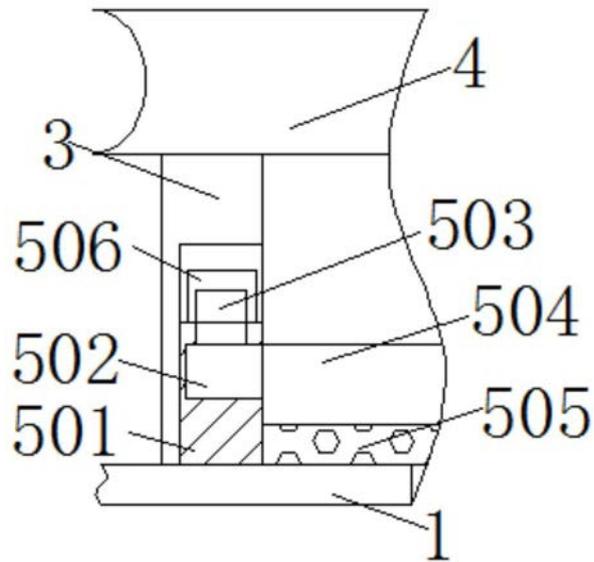


图2

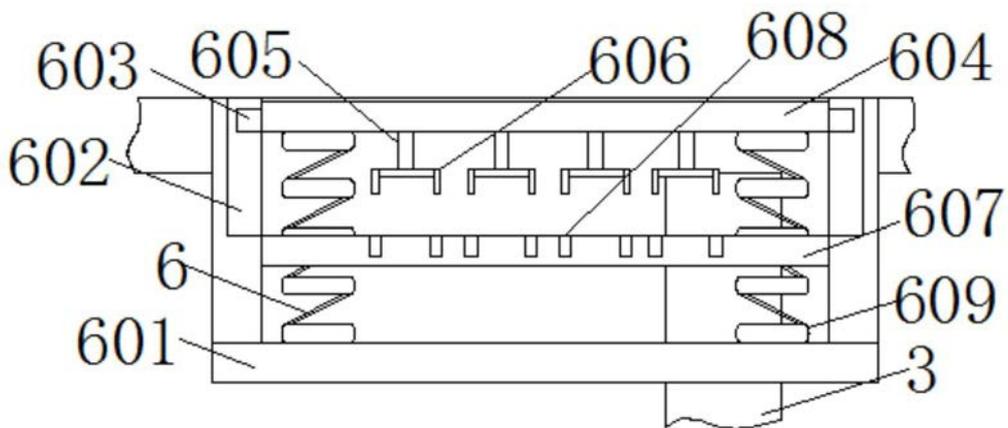


图3

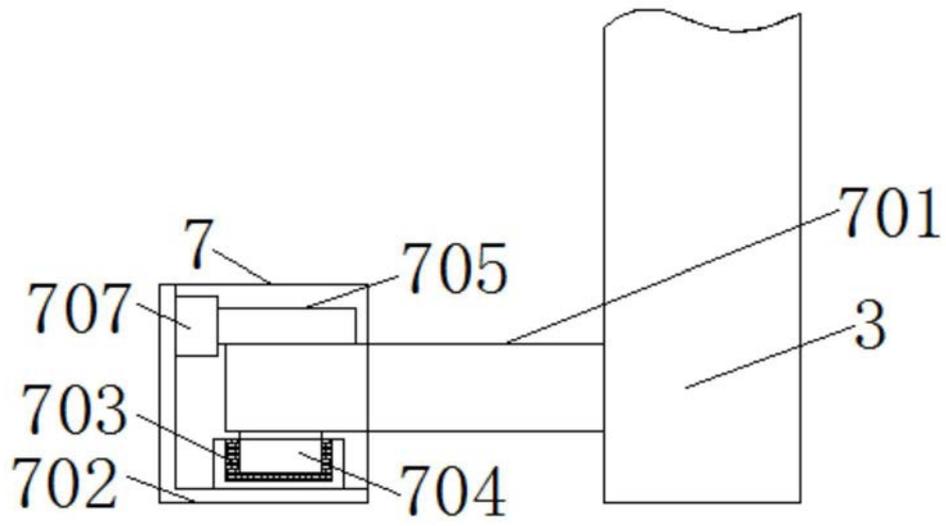


图4

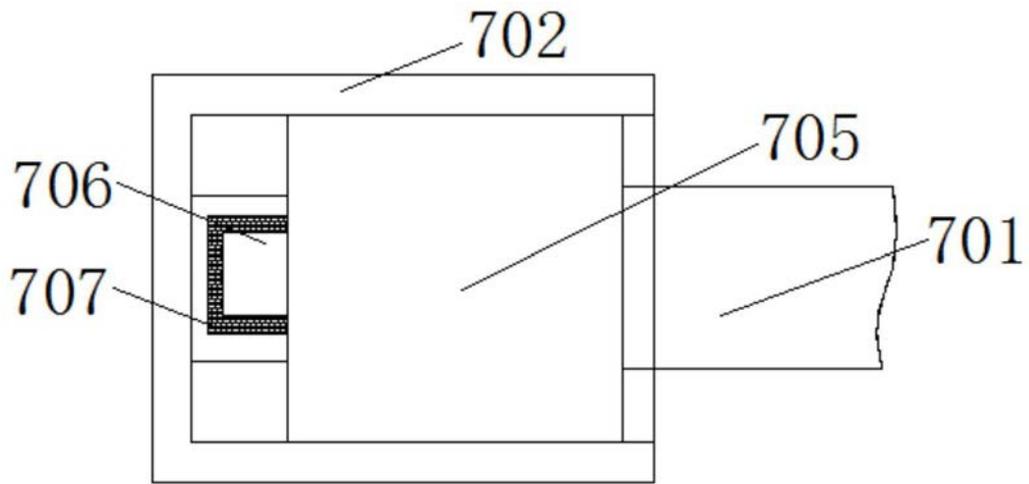


图5